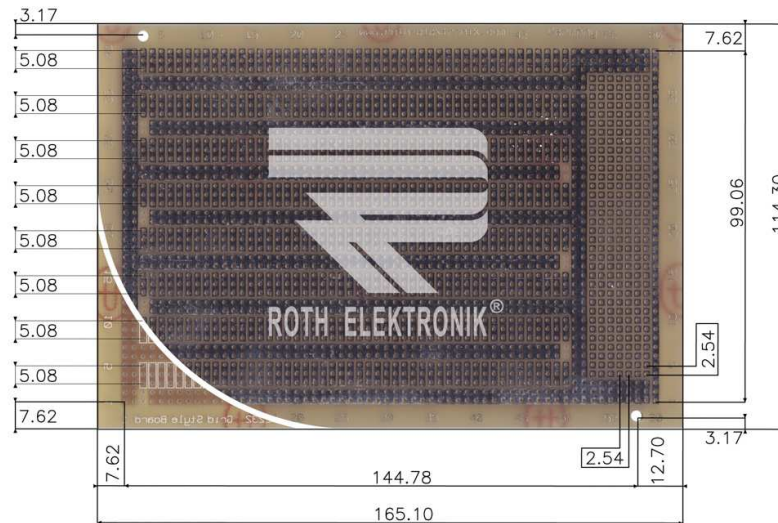


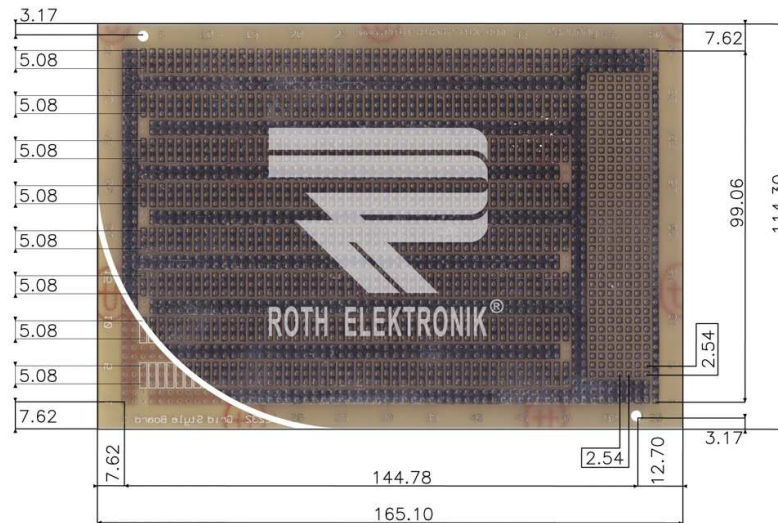
RE232-LF

- Epoxy fibre-glass FR4 1.60 mm
- Single-side 35 µm Cu
- Hot air leveling (HAL-leadfree)
- Component print
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 40 x 60 tracks of bored holes
- 3-hole pads
- Hole diameter 1.02 mm (0.40")
- 4 rows DIP IC grid 7.62 mm, 15.24 mm with 48 terminal pins
- Max. working temperature 150 °C (320 °F)
- Size 114.30 mm x 165.10 mm (4.5" x 6.5")



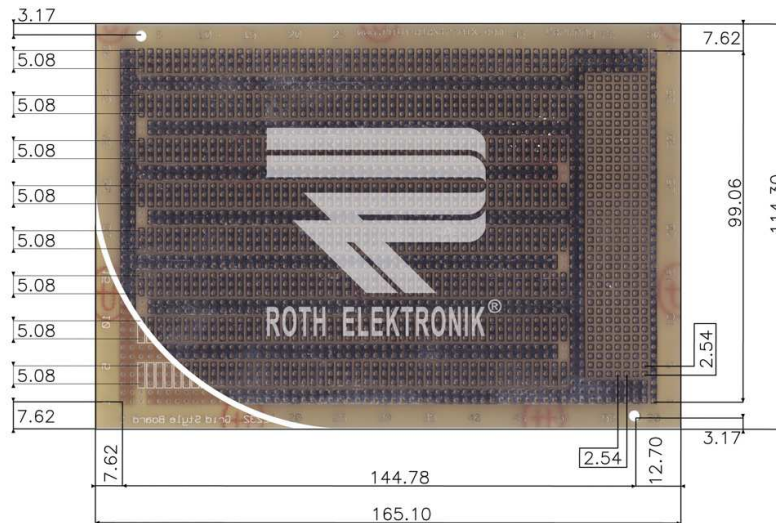
RE232-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,60 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Bestückungsdruck
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 Lochreihen
- 3-Loch Lötinseln
- Lochdurchmesser 1,02 mm (0,40")
- 4 Reihen DIP IC Raster 7,62 mm, 15,24 mm mit 48 Anschlüssen
- Max. Betriebstemperatur 150 °C (302 °F)
- Größe 114,30 x 165,10 mm (4,5" x 6,5")



RE232-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 1,60 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Impression d'insertion
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 pistes de perforation
- îlots de brasage à 3 trous
- Perforation 1,02 mm (0,40") Ø
- 4 pistes DIP IC pas 7,62 mm, 15,24 mm avec 48 pattes
- Température de service maximale 150 °C (302° F)
- Dimensions 114,30 mm x 165,10 mm (4,5" x 6,5")



RE232-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 de 1,60 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Estañado en caliente (HAL-leadfree)
- Impresión de dotación por el lado de los componentes eléctricos
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 40 x 60 hileras de agujeros
- Nodos de soldadura de 3 agujeros
- Diámetro de los agujeros 1,02 mm (0,40")
- 4 hileras DIP IC, trama de 7,62 mm, 15,24 mm con 48 conexiones
- Temperatura máx. de servicio 150 °C (302 °F)
- Tamaño 114,30 mm x 165,10 mm (4,5" x 6,5")